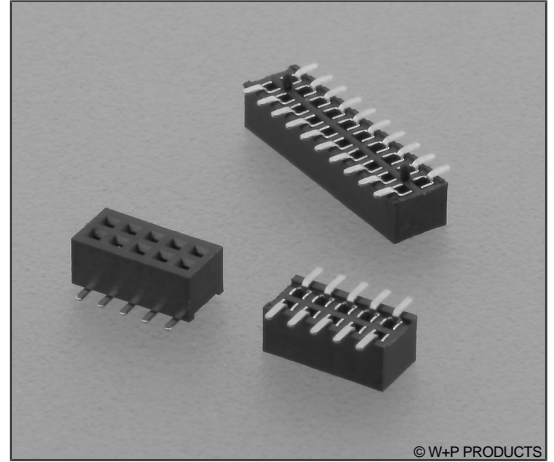


SMT-Buchsenleisten RM 1,00mm, stehend, 2-reihig SMT Female Headers, 1.00mm Pitch, Vertical, Double Row

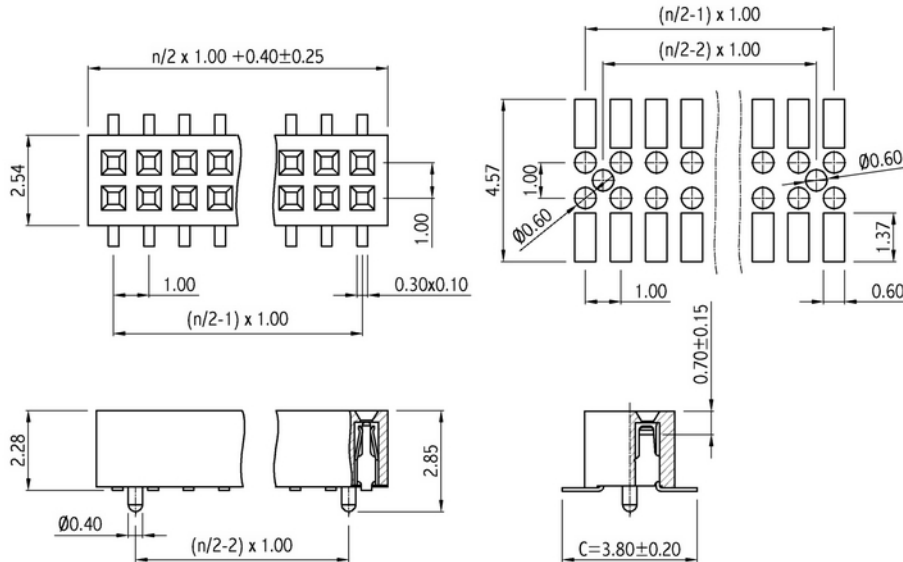
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Gold über Nickel <i>Gold over nickel</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ < 20mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ > 1000MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500V _{AC} 500V _{AC}
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A 1A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40°C ... +105°C -40°C ... +105°C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Doppelfederkontakte für
Vierkantstifte 0,30mm.
Dual beam contacts accept
0.30mm square pins.



Recommended
PCB Layout

Series	Contacts*	Profile	Plating	Locating Pegs*	Packaging*
7091	100 010-100 Zweireihig Double row	30 30 2,28mm, Eingang oben 2.28mm, top entry	00 00 Vergoldet Gold plated	10 00 Ohne Pos.hilfen W/o loc. pegs 10 Mit Pos.hilfen With loc. pegs	ST ST PPST PPTR FST FTR

Einsteckkräfte max. 1,02 N / Kontakt beim 1. Stecken.
Mating forces max. 1.02 N / contact during 1st mate.

Lieferformen / Packaging Options:

ST	In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads
PPST	In Stangen mit P&P-Pads / In tubes with P&P-Pads
PPTR	Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads
FST	In Stangen mit P&P-Film Pads / In tubes with P&P-Film Pads
FTR	Tape & Reel mit Film Pads / Tape & Reel with Film Pads

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

